

## TEK.DAY 2023

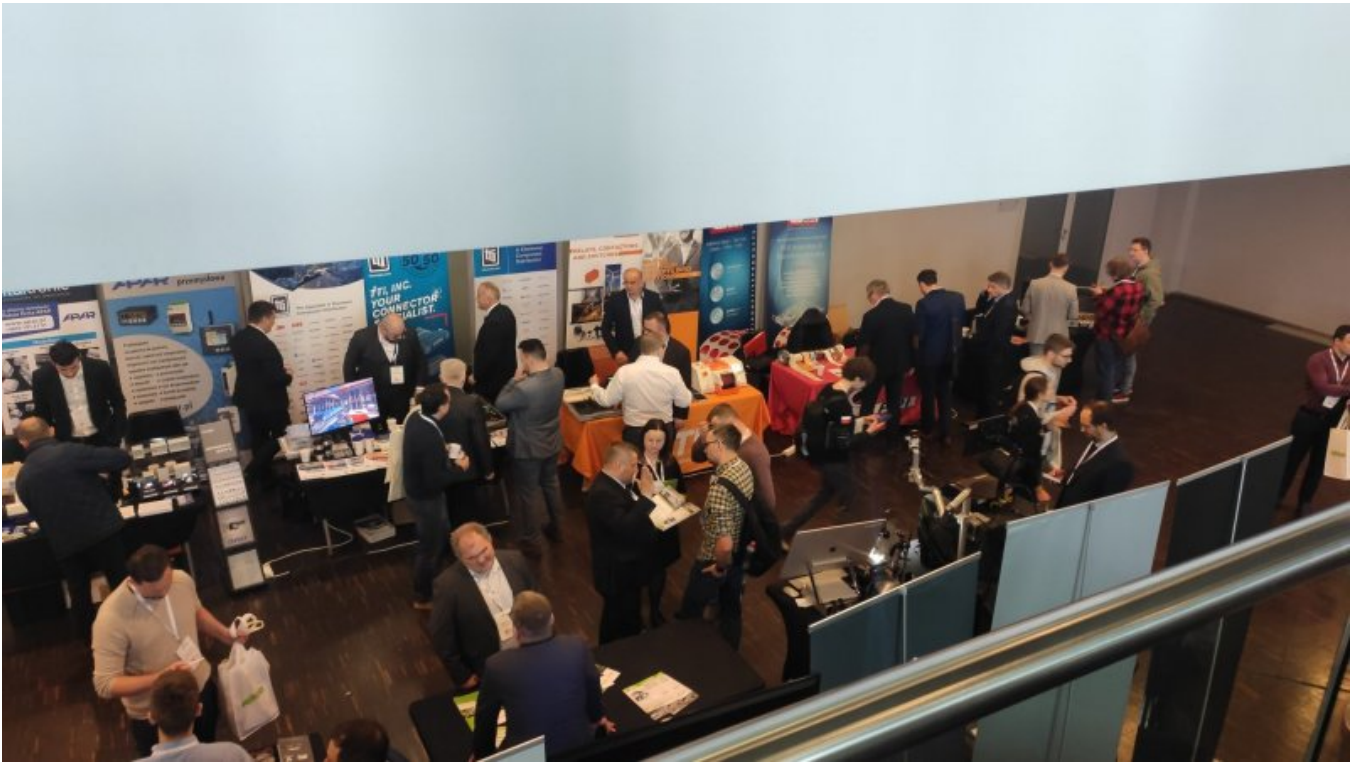
**W dniu 30 marca 2023 roku delegacja członków Oddziału Szczecińskiego SEP (Jakub Ciurus – student I roku studiów niestacjonarnych na Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie; Kamil Cierzniewski – sekretarz OS SEP i doktorant Szkoły Doktorskiej ZUT w Szczecinie) uczestniczyła w interesującej konferencji - TEK.day, która miała miejsce w Business Club'ie na Tarczyński Arena we Wrocławiu. Było to jednodniowe wydarzenie, związane z projektowaniem i produkcją elektroniki, łączące w sobie targi w formule table-top oraz szereg interesujących wykładów, a także imprezy towarzyszące.**

W trakcie trwania wydarzenia uczestnicy mogli zapoznać się z zakresem działalności i portfolio ponad 120 firm związanych z szeroko pojętą branżą elektroniki m.in. z aparaturą pomiarową, wytwarzaniem płytek PCB, a także produkcją oraz sprzedażą materiałów i komponentów elektronicznych. Targom towarzyszyły interesujące wykłady przeprowadzone przez specjalistów z uznanych przedsiębiorstw dotyczące najbardziej aktualnych problemów, przed którymi stoi krajowa i światowa elektronika. Poruszały one tematy związane z m.in.: oceną zgodności wyrobów elektronicznych, analizą i zapobieganiem zaburzeniom wstępujących w układach PCB, aktualnej sytuacji w branży produkcji półprzewodników, analizą różnych strategii rozwoju zespołów R&D, metodami stosowania żywic w elektronice oraz nowoczesnymi badaniami z zakresu kontroli jakości produktów półprzewodnikowych.

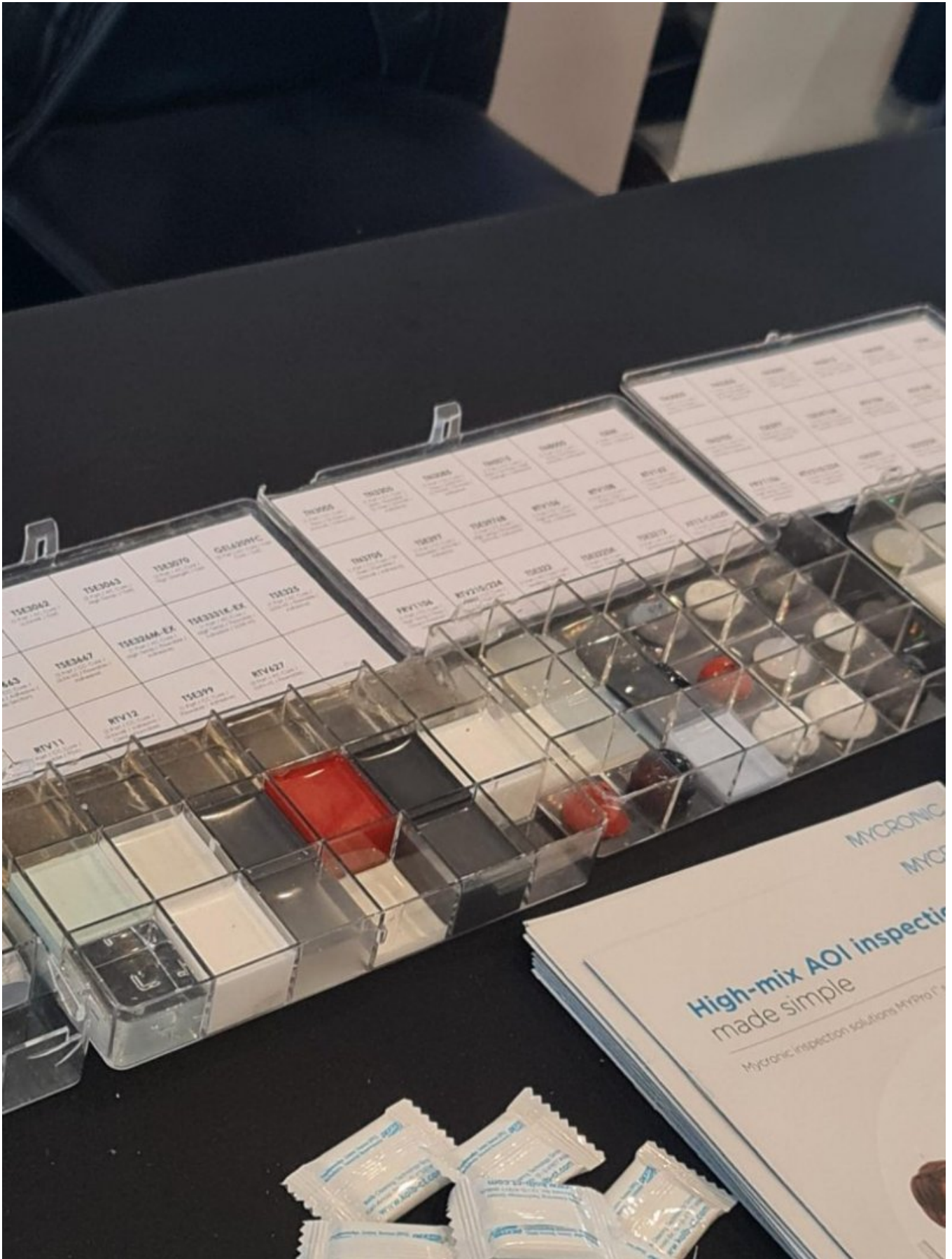
Udział w TEK.day 2023 we Wrocławiu pozwolił delegatom z Oddziału Szczecińskiego SEP zapoznać się działalnością uznanych firm z branży elektronicznej oraz ich często innowacyjnymi wyrobami. Dodatkowo wydarzenie umożliwiło poszerzenie wiedzy z zakresu elektroniki oraz rozwiązywania problemów technicznych występujących w zakładach przemysłowych. Wierzymy, że nabyta wiedza i kontakty ułatwią wypracowanie osiągnięć zawodowych i naukowych w przyszłości!

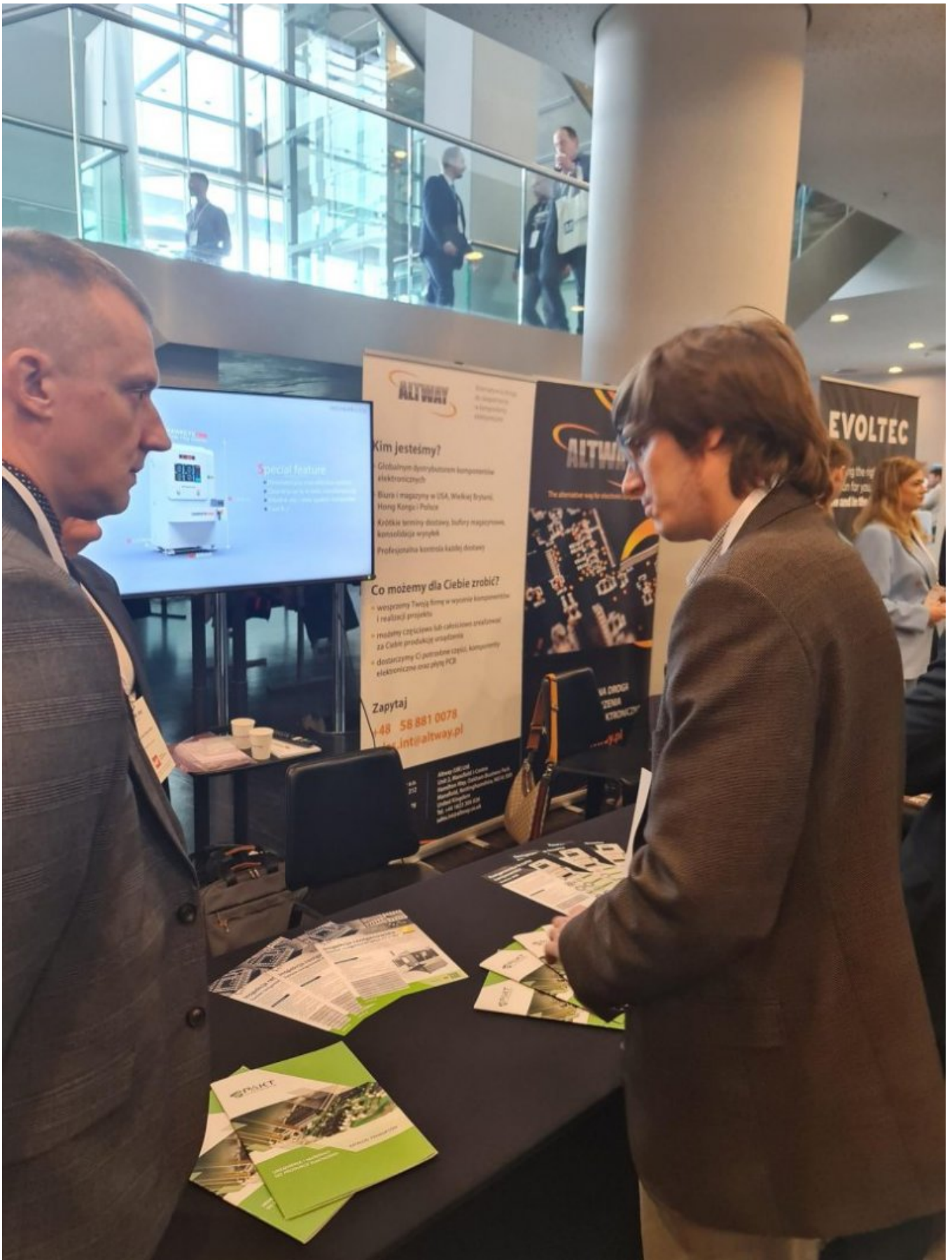
*Redakcja TwS*

*zdjęcia: Jakub Ciurus i Kamil Cierzniewski*















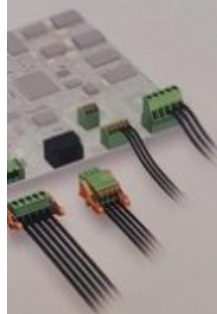








Przylączy dla aplikacji przemysłowych i infrastruktury.



### COMBICON control

Technika przyłączy do pomiarów i sterowania.

- Prądy do 41A
- Napięcia do 630V
- Przekroje przewodów do 6mm<sup>2</sup>
- Raster od 2,5 do 7,62mm
- Przyłącze krótkow. sprężynowe kładowe, sprężynowe Push-in, zaciskane lub IDC

### ON compact

Przylączy dla aplikacji LED

Przewodów do 4mm<sup>2</sup> do 7,5mm, sprężynowe lub IDC



Obudowy dla elektroniki przemysłowej, automatyki budynków i urządzeń pracujących w trudnych warunkach środowiskowych



### Systemy obudów idealne dla automatyki budynków

- Zaprojektowane zgodnie z normą DIN 43880, określającą wymiary standardowych aparatów elektrycznych montowanych np. w domowych szafkach rozdzielczych
- Wielobiegunowa magistrala łącząca moduły, zatrzaskiwana na dnice szyny DIN
- Łatwa integracja systemów przyłączy z szerokiej oferty Phoenix Contact

### Systemy obudów dla aplikacji przemysłowych

- Szeroki program obudów standardowych do montażu na szynie DIN
- Przyłącza zintegrowane lub dowolnie konfigurujące
- Możliwe dostosowanie elementów do indywidualnych wymagań (rozmiar, kolor, nadruki, otworowanie)

